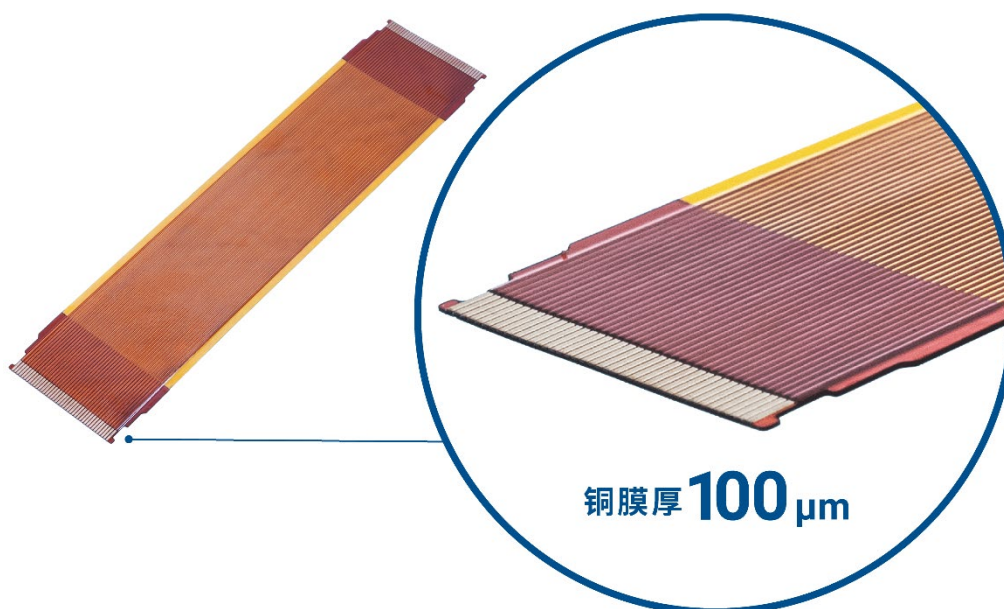


Elephantech 发布超薄铜 ($<1\mu\text{m}$) · 超厚铜 ($>100\mu\text{m}$) 柔性电路板并投入量产, 持续扩充碳中和产品线 SustainaCircuits™

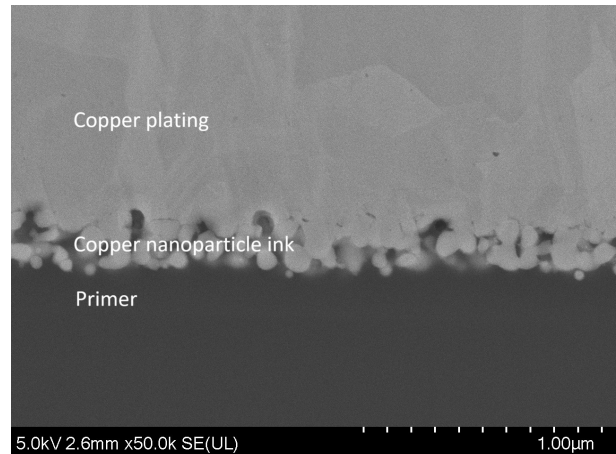
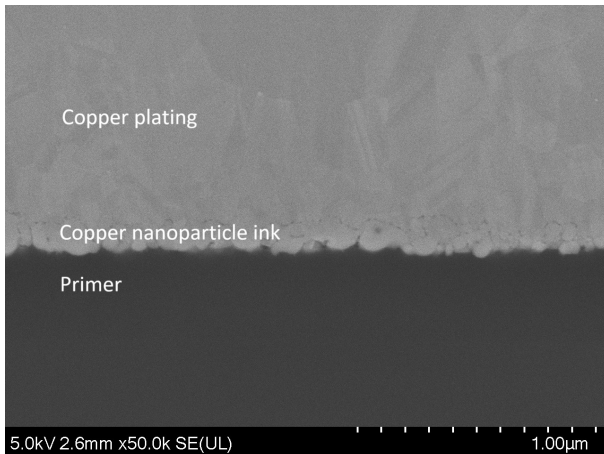
继 2020 年成功实现碳中和喷墨印刷技术 SustainaCircuits™ 的量产, Elephantech 已成功推出了 $3\sim 12\mu\text{m}$ 厚铜膜的系列柔性线路板(FPC) 产品。为了进一步应对日益多样化的市场需求, Elephantech 持续技术创新, 将可量产的线路板铜膜厚度范围大幅度扩展。

(超厚铜柔性电路板实物照片-铜膜厚 100 微米)



量产可承接设定铜膜厚度范围	
已有	$3\sim 12\mu\text{m}$
新增	超薄铜 : $<1\sim 3\mu\text{m}$
	标准铜 : $3\sim 35\mu\text{m}$
	超厚铜 : $35\sim 100\mu\text{m}$ ($100\mu\text{m}$ 以上已在开发中)

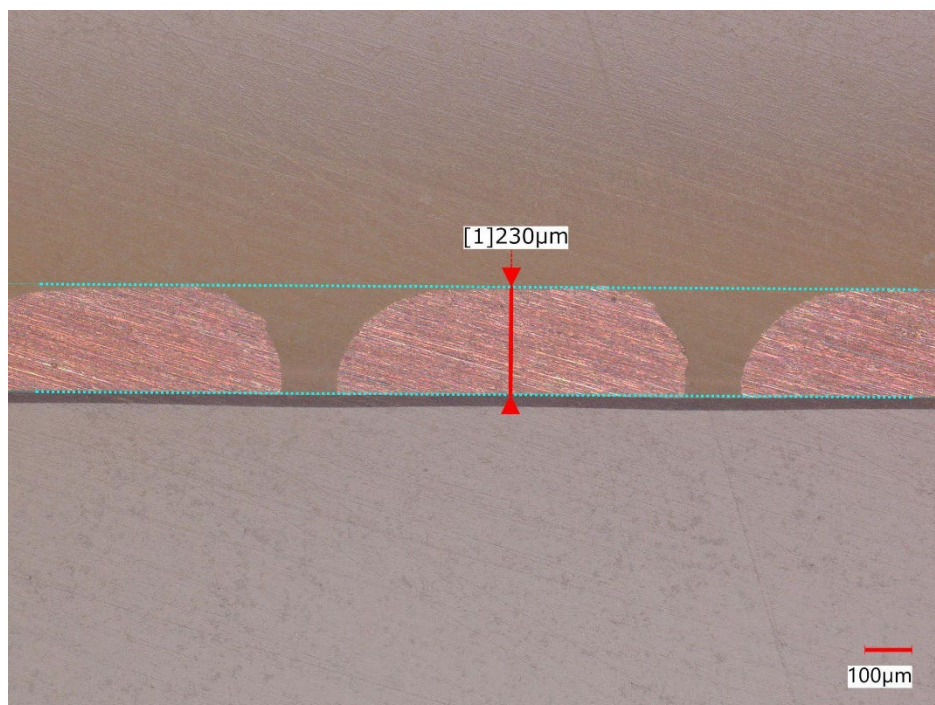
本次革新得益于喷墨印刷材料和流程工艺的两方面成功推进。通过应用新开发的底漆材料, 让铜纳米粒子得以渗入两种材料界面的细微缝隙, 实现物理锚固效果。



同时在支持既有 25 微米聚酰亚胺基材的基础上，新增 12.5 微米规格，进一步减少整体成品的体积，目前这一突破已开始应用于产品开发。

新的生产流程运用了 Elephantech 开发的独特电解铜镀技术，SustainaCircuits™全线产品，无论是柔性还是刚性线路板，都仅在需要处打印铜线，摆脱传统的蚀刻工艺，在超厚铜线路板上达成更为显著的原材料用量削减，实现降本增效和减轻环境负担两方面卓越效果。

这一突破让 Elephantech 可以应对更加多样、灵活的线路板生产需求，特别是当前市面上常见的铜厚 18、35 微米之外的规格。从小于 1 微米到 100 微米的任何设定厚度，Elephantech 都可以量产供给，同时开发能力已经达到 200 微米级别。



超厚线路板的量产，将有力推进电力电子领域的高电流应用场景，如汽车、工业设备、电池应用以及线束替代等，并在这些应用领域逐步替代传统双面柔性线路板，目前已有多个项目在进行中。

详情请浏览 Elephantech 官网 <https://elephantech.com/en/> 同时欢迎您通过官网上的“联系我们”留言，将有技术专家与您取得联系。

关于 Elephantech

Elephantech 致力于通过创新实业打造可永续发展的全新世界。作为一家初创企业，Elephantech 正以其独特的金属喷墨打印技术 SustainaCircuits™ 重塑打印线路板（PCB）行业。与传统“减法”工艺相比，SustainaCircuits™ 显著减轻环境负担，降低 75% 的碳排放，95% 的废水和 70% 的铜用量。